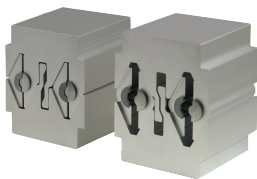


Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Type	Arbeider med	Pakkeantall	Dybde	Bredde
---------------	------	--------------	-------------	-------	--------

24830-001	Varmeleder	Tilfeller	1	50 mm	50 mm
-----------	------------	-----------	---	-------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE